

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-022

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实施公司发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称“中山易天”)、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称“微组半导体”)、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司(以下简称“易天半导体”)日常经营，公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增不超过 25,000 万元担保额度，拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，合计担保额度不超过 31,000 万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 4 月 24 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为子公司提供担保事项，尚需提交股东会审议。

具体担保对象和提供担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前实际担保余额(万元)	本次审批的担保额度(万元)	截至目前审议的担保额度总金额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
公司	中山易天	100	38.70	4,276.38	25,000	35,000	45.57	否
公司	微组半导体	52.5	69.59	2,000	3,000	3,000	3.91	否
公司	易天半导体	60	251.76	0	3,000	3,000	3.91	否
合计				6,276.38	31,000	41,000	53.38	-

二、被担保人基本情况

（一）中山易天

1、中山易天基本情况

公司名称	中山市易天自动化设备有限公司
法定代表人	柴明华
成立时间	2017 年 12 月 18 日
注册资本	25,770.3928 万元
实收资本	25,770.3928 万元
统一社会信用代码	91442000MA5153XG37
注册地和主要经营地	中山市板芙镇智能路 2 号
与公司存在的关联关系	为公司全资子公司（公司持有中山易天 100%的股权）
经营范围	一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、中山易天的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	40,459.93	35,948.95

总负债	15,657.31	10,975.60
净资产	24,802.62	24,973.35
营业收入	16,409.39	15,679.04
营业利润	214.52	-1,004.91
净利润	-170.73	-165.63

注：上述财务数据均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

中山易天自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

（二）微组半导体

1、微组半导体基本情况

公司名称	深圳市微组半导体科技有限公司
法定代表人	王文
成立时间	2017 年 10 月 18 日
注册资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5ERYA88Q
注册地和主要经营地	深圳市光明区马田街道薯田埔社区星源先进材料产业园 4 栋 1301
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有微组半导体 52.5%的股权）
经营范围	一般经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。

2、微组半导体股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	深圳市易天自动化设备股份有限公司	1050	52.5%
2	王文	380	19%
3	深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）	240	12%

4	林佛迎	90	4.5%
5	王贺	75	3.75%
6	万晓峰	30	1.5%
7	张艳利	60	3%
8	蔡木林	60	3%
9	刘宁	15	0.75%
-	合计	2000	100%

3、微组半导体的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	8,722.67	6,360.28
总负债	6,070.29	4,294.31
净资产	2,652.37	2,065.97
营业收入	6,481.63	5,337.83
营业利润	518.38	492.20
净利润	528.40	508.14

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

微组半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

（三）易天半导体

1、易天半导体基本情况

公司名称	深圳市易天半导体设备有限公司
法定代表人	张清涛
成立时间	2021 年 8 月 26 日
注册资本	1000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GYD9H8D
注册地和主要经营地	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有易天半导体 60%的股权）

经营范围	一般经营项目：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；金属切割及焊接设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；环境应急检测仪器仪表销售；电子办公设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
------	---

2、易天半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股份有限公司	600	60%
黄招凤	400	40%
合计	1000	100%

3、易天半导体的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	5,777.13	11,009.75
总负债	14,632.75	14,417.42
净资产	-8,855.63	-3,407.68
营业收入	385.44	330.32
营业利润	-5,221.45	-3,220.11
净利润	-5,979.15	-2,723.54

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

易天半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

三、担保内容

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保

等方式。

2、合计最高担保额度：公司本次为全资子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增不超过 25,000 万元担保额度，为控股子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，为控股子公司易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，合计不超过 31,000 万元担保额度。

3、有效期及授权：担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

4、在前述担保额度内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司中山易天、为控股子公司微组半导体、控股子公司易天半导体提供的担保系为保证子公司的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。考虑到公司能够对子公司的经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并提请股东会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司董事会审议的对外担保总额为人民币 41,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 53.38%；实际提供担保总余额为人民币 6,276.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.17%。公司及子公司无对合并报表范围外单位提供担保的情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日